

ASSIGNMENT	CESIÓN
TUNCHEL, Ivo; WARD, Gary; and SHACHNAI, Asaf by means of this document assigns to STEPAC L.A. LTD.	TUNCHEL, Ivo; WARD, Gary; y SHACHNAI, Asaf por medio de la presente cedemos a STEPAC L.A. LTD.
A company organized under the laws of Israel	Una compañía organizada bajo las leyes de Israel
Domiciled in Tefen Industrial Park, Bldg. 12 2495900 Tefen, Western Galilee, Israel	domiciliada en Tefen Industrial Park, Bldg. 12 2495900 Tefen, Western Galilee, Israel
all our rights, title and interest in and to our invention for a new and useful improvement entitled and as fully set forth and described in: SYSTEM AND METHOD FOR PACKAGING PRODUCE	todos nuestros derechos, títulos e intereses sobre y para nuestra invención referente a una mejora nueva y útil titulada y como se expone y describe en: SISTEMAY MÉTODO PARA EMPACAR PRODUCTOS
Given and signed this <u>29TH MAY</u>, 2024 in <u>TEFEN, ISRAEL</u> by _____ TUNCHEL, Ivo  _____ WARD, Gary  _____ SHACHNAI, Asaf	Dado y firmado hoy <u>29 de mayo de</u> 2024 en <u>Tefen, Israel</u> por _____ TUNCHEL, Ivo Firmado Ilegible _____ WARD, Gary Firmado Ilegible _____ SHACHNAI, Asaf

This document does not need legalization.

Please send us this document signed by the inventors by email.

<u>ASSIGNMENT</u>	<u>CESIÓN</u>
<i>TUNCHEL, Ivo; WARD, Gary; and SHACHNAI, Asaf</i> by means of this document assigns to <i>STEPAC L.A. LTD.</i> A company organized under the laws of <i>Israel</i> Domiciled in <i>Tefen Industrial Park, Bldg. 12 2495900 Tefen, Western Galilee, Israel</i> all our rights, title and interest in and to our invention for a new and useful improvement entitled and as fully set forth and described in: <i>SYSTEM AND METHOD FOR PACKAGING PRODUCE</i>	<i>TUNCHEL, Ivo; WARD, Gary; y SHACHNAI, Asaf</i> por medio de la presente cedemos a <i>STEPAC L.A. LTD.</i> Una compañía organizada bajo las leyes de <i>Israel</i> domiciliada en <i>Tefen Industrial Park, Bldg. 12 2495900 Tefen, Western Galilee, Israel</i> todos nuestros derechos, títulos e intereses sobre y para nuestra invención referente a una mejora nueva y útil titulada y como se expone y describe en: <i>SISTEMAY MÉTODO PARA EMPACAR PRODUCTOS</i>
Given and signed this <u>29 May</u>, 2024 in <u>Tefen, Israel</u> by  TUNCHEL, Ivo _____ WARD, Gary _____ SHACHNAI, Asaf	Dado y firmado hoy <u>29 de mayo de</u> 2024 en <u>Tefen, Israel</u> por  TUNCHEL, Ivo _____ WARD, Gary _____ SHACHNAI, Asaf

This document does not need legalization.

Please send us this document signed by the inventors by email.